

우진아이엔에스, 하이테크 기계설비 산업의 글로벌 기업으로 도약

- ▶ 국내 특수 코팅덕트 분야의 선도기업
- ▶ 반도체 산업의 성장으로 하이테크 설비시장 지속 성장
- ▶ 신기술인 로토프론 코팅 기술을 통해 지속 성장동력 확보

<2018-08-31> 국내 기계설비 선도기업 우진아이엔에스(대표이사 홍평우, 손광근, 홍경모)가 31일 기자간담회를 개최하고 유가증권 상장에 대한 각오와 비전을 밝혔다.

1975년 설립된 우진아이엔에스는 건축물의 공조설비 및 소방설비 등의 시공사업과 산업 시설용 특수덕트인 하이테크 기계설비를 생산, 시공하는 기계설비 전문기업이다. 44년의 업력과 우수 고객과의 네트워크를 기반으로 불소수지 코팅덕트를 개발, 국내 반도체 생산시설의 필수 설비인 하이테크 기계설비를 생산하는 기업으로 성장했다.

반도체 생산공정에서 발생하는 강한 산 및 알칼리 성분의 배기는 덕트 및 배관 등의 설비에 부식을 일으켜 배기 효율성을 떨어트리고 생산시설의 안전을 위협한다. 우진아이엔에스는 기존 반도체 공정에서 사용되던 PVC, FRP 등 비닐 수지 계열 덕트 대비 내열성, 내화재성이 우수한 ETFE, CPT 소재의 불소수지 코팅덕트를 개발해 1999년부터 삼성전자 화성 반도체 생산라인에 공조덕트를 시공하며 하이테크 설비 시장으로 진출했다.

삼성전자에 공급을 시작으로 SK하이닉스에도 제품을 공급하며 국내 반도체 시장의 성장과 함께 실적도 급격히 성장했다. 최근 삼성전자와 SK하이닉스의 설비투자로 우진아이엔에스는 2015년 매출액 924억 원에서 2017년 1,404억 원으로 증가해 연평균 성장률 23.3%를 기록했으며, 올해 상반기 매출액 역시 지난 성장을 이어오며 전년 동기 대비 44.5% 증가한 834억 원을 기록했다.

우진아이엔에스는 앞으로도 성장세가 더욱 지속될 것으로 기대된다. 최근 4차산업혁명으로 인해 반도체 시장이 호황을 맞아 삼성전자 및 SK하이닉스의 설비투자가 지속되고 있으며, 중국의 반도체 굴기로 코팅덕트의 수요가 지속되고 있기 때문이다. 또한 D램의 미세화, NAND의 고단화로 증착/식각 공정이 증가하며, 반도체 생산공정의 화학물 및 가스의 사용량이 증가해 코팅덕트의 수요는 더욱 증가하고 있는 상황이다.

회사는 반도체 공정의 변화에 적극적으로 대응하고 타 산업으로 적용 범위를 넓히기 위해 로토프론 방식의 코팅 신기술을 도입하고 있다. 로토프론 코팅기술은 기존 코팅 대비 약 10배 이상의 두께로 코팅막을 형성하고, 제품의 모양에 제약이 없는 신기술이다. 회사는 로토프론 코팅기술을 통해 독성이 더욱 강해지고 있는 반도체 공정에 대응하고, 반도체 산업뿐 아니라 화학 및 정유 산업으로 고객군을 확대할 계획이다.

우진아이엔에스는 고객군 확대와 더불어 글로벌 시장으로도 시장 확대를 준비하고 있다. 2013년 중국 시안

법인을 설립하여 중국시장 진출에 교두보를 마련하였고, 중국 로컬기업을 대상으로 영업을 진행하고 있어 글로벌 시장으로 하이테크 설비시장을 확대한다는 계획이다.

우진아이엔에스 손광근 대표이사는 “우진아이엔에스는 오랜 업력과 끊임없는 기술개발로 국내 하이테크 기계설비 선도기업으로 성장했다”며, “이번 유가증권 시장 상장을 계기로 신기술을 장착하고 반도체 산업 외 다양한 산업과 글로벌 시장으로 고객군을 확장해 나갈 것”이라고 전했다.

한편 우진아이엔에스는 이번 공모를 통해 총 210만주를 공모하며, 공모예정가는 15,000원~17,000원이다. 8월 30일~31일 수요예측을 거쳐 공모가를 확정하고, 9월 5일~6일 청약을 진행한다. 9월 14일 유가증권 시장에 상장할 예정이며, 신영증권이 상장 대표주관을 맡았다.